平成30年度

公益財団法人 天田財団助成式典

【助成金目録贈呈式／招待講演会／懇親会】

【日時】平成30年12月1日(土)（13:00～18:30）

【場所】フォーラム246【246ホール】

〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田350

次第

1 開　　式（13:00～）

2 挨　　拶　天田財団 代表理事理事長　岡本　満夫

3 来賓祝辞　経済産業省 素形材産業室長　岡本　繁樹 様

（株）アマダホールディングス代表取締役社長　磯部　任 様

4 助成金目録贈呈式（13:30～14:50）

4-1　【総評】天田財団評議員／慶應義塾大学 名誉教授　小原　實

4-2　重点研究開発助成

4-3　一般研究開発助成

4-4　奨励研究助成（若手研究者）

4-5　国際交流助成

5 招待講演会（15:00～16:00）

豊橋技術科学大学大学院 教授　森　謙一郎 様

『超高強度鋼部材の次世代スマートホットスタンピングの開発』

九州工業大学大学院 教授　楢原 弘之 様

『3次元金属積層造形におけるレーザ焼結プロセスの可視化と高機能金型製造への応用』

6 アマダソリューションセンター　ご視察（16:10～16:55）

7 懇親会（17:00～18:30）

【挨拶】天田財団理事／電気通信大学 特任教授　千野　俊猛

公益財団法人 天田財団 THE AMADA FOUNDATION